

6.1 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

报告期内,上半年,国际、国内主要原材料大幅涨价,人民币持续升值,给公司经营带来很大压力;下半年主要原材料价格大幅回落,全球金融危机向实体经济蔓延,国内需求大幅萎缩,面对外部环境的急剧变化,公司在董事会的领导下,通过管理层及全体员工的共同努力,加强品质管理,深化成本控制,克服众多不利因素影响,2008年全年度实现销售524,265,399.30元,同比增长10.58%,净利润实现16,794,821.48元,同比下降37.27%。

二、公司面临的主要风险及应对措施:
1、公司目前具备的优势:
(1) 公司一直以来坚持“以人为本、中国的价格、六星级的服务”的经营理念,以行业领先的技术,可靠的产品质量来满足客户的需求,确立了国内的行业标杆地位。公司的竞争优势主要体现在:
(1) 拥有行业内完善的质量控制体系;
(2) 1995年至今,公司先后导入ISO9001、QS9000、ISO14000、OHSAS18000、TS16949、QCD0000、ISO27001七套国际认证体系,保证了产品技术领先和质量稳定。

(3) 拥有完善的生产工艺:根据客户需求为客户提供量身定制的产品设计到最终产品加工的整体解决方案,最大限度的满足客户的需求。
(4) 在二、三级管理网络方面:公司拥有从产品设计-芯片制造-封装测试-产品销售-集成应用的一体化产业链;
(5) 在芯片制造方面:公司拥有4英寸芯片生产线,能在行业内领先的4英寸工艺平台上生产各种二级管理芯片。

(6) 在集成电路封装领域:公司是国内最早从事QFN封装封装并实现产业化的企业,目前能够生产各种QFN封装的集成电路产品,是国内最大的QFN封装企业。
(7) 在一定的产品规模效应:公司目前是国内最大的集成电路生产商,产品产量约占全球二级管理产量的7-8%;其中,1.5英寸二级管理产量全球第一,约占全球市场份额的70%,片式微型栅阵列产品全球第一。

(8) 拥有良好的市场口碑:公司先后被柯达、索尼等多家国际大公司评为优秀供应商或合作伙伴,目前已与行业内世界前三大生产商建立了 OEM/ODM 合作关系,保证了公司技术和产品的先进性。
(9) 完善的管理制度:职业经理人制度的推行吸引了全球范围内行业精英加盟,公司的新品研发能力突出。

二、面临的主要风险:
除了自身的竞争优势之外,随着国家电子信息产业振兴计划的实施,3G技术的发展和应用,公司所处的半导体行业在未来数年的景气程度持续向好,也保证了公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。经济危机发生以来,国际、国内市场环境发生了很大变化,公司面临的主要困难有:
1、国际市场需求萎缩,给公司经营带来一定的影响;
2、原材料价格波动是成本价格波动的重要因素,给公司经营带来一定的影响;
3、由于国内最终用户对产品质量的差异化需求,导致公司国内市场开拓难度高于国外市场。

三、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析:
1、行业发展趋势:
根据信息产业部发布的《2008年中国电子信息产业发展报告》显示:
2008年中国电子信息产业实现主营业务收入6.3万亿元,同比增长12.5%。计算机、家用视听、电子元件行业利润均出现负增长,其中电子元件行业利润下降1.6个百分点。随着国际金融危机冲击效应逐步显现,规模以上制造业亏损面达到25%,同比提高2个百分点;集成电路行业利润分别下降4.5%和10.8%,电子元件行业利润则同比下降了34个百分点。
2009年,我国电子信息产业面临严峻挑战,“一降两升”成为行业发展的主要特征。一是行业景气度下降,二是行业景气度回升,三是行业景气度回升。

2008年,分立器件行业主要原材料硅片的价格剧烈波动,放大了国内企业的经营压力,金融危机的发生,各企业为保住原有市场份额和开拓新市场,仍将降价作为产品促销的手段。同时,由于国际市场需求不振,分立器件行业将进一步加大对中国市场的开拓力度,进一步深耕中国市场,国内企业经营将更加艰难;国内一些新产品市场兴起,将进一步吸引国外企业,潜在的市场竞争将逐渐升温。这既加剧了分立器件行业竞争的态势。

本公司相较于国内企业,无论在规模、技术、客户类型、销售网络、产品质量等方面都已走在行业的前列,但和国际最主要的分立器件供应商抗衡的能力仍待加强,特别在核心技术上的突破仍是制约企业继续发展的主要瓶颈。
四、公司发展战略:
1、公司利用已经建立的营销网络,聚焦主业——二极管,通过“二极管超市”的规模效应扩大市场,继续做大做强。紧紧围绕公司“T”型发展战略,“T”型发展战略的轴心为二极管,二极管的核(“一”字)延伸,轴心代表二极管的外延——封装技术,“一”字延伸到分立器件,芯片制造技术决定了一般的工艺技术和质量水平,一般封装制造“工艺”和“封装”两种材料的技术突破——封装可以应用于不同场合,一般是封装制造工产品的保护和封装,在“上”流工序上,封装技术处于上游,封装技术处于下游,以上公司封装技术第一集团军的主力。

2、公司将抓住 QFN/DFN 封装集成电路制造的优势和 GPV 芯片设计技术,大力拓展国际和国内市场的销售,并积极开展国际第一集团军的 OEM/ODM 合作,巩固国内第一地位,打造公司在集成电路封装领域的品牌优势。
3、公司将利用多年形成的快速反应机制,进一步加强市场和新品开发,不断寻求新的利润增长点,发挥公司的特别效应。

五、公司 2009 年度经营计划:
2009 年是公司发展的关键之年,随着金融危机向实体经济蔓延的加剧,自 2008 年 11 月份开始,公司海外订单出现大幅下滑,行业内前 10 大生产商均出现不同程度亏损,行业重新洗牌的时刻即将到来,公司在充分考虑金融危机影响因素以后,2009 年销售收入力争比 2008 年增长 2%,税前利润/每股收益比 2008 年增长 10%左右,为此,公司将采取以下措施:
1、依托 QFN/DFN 封装集成电路制造的优势,大力拓展国内市场的销售;同时积极开展和国际第一集团军的 OEM/ODM 合作,巩固国内第一地位。

2、利用 GPV 芯片设计和生产成熟稳定的优势,加大对 TVSENERGY 的产品生产规模,显现技术和成本优势,进一步拓展国内市场和与国际第一集团军的 OEM/ODM 的业务合作;同时加大汽车电子封装制造产品进入国内市场的力度,争取获取更多、更大的订单,建立自己的品牌优势。
3、发挥封装制造对分立器件产品及模块的设计专利及制造技术优势,积极拓展国际第一品牌的认证和销售,产生新的利润增长点。

4、加强外协管理力度,整合公司和被控单位的优势资源,产生市场效应,拓宽市场和客户资源。
5、加大投入力度,改善的营销品牌效应和国内第一的领先地位,提高国内市场占有率及与国际第一集团军的合作,进一步做强做大。

六、风险提示:
1、宏观经济波动带来的国际大公司的危机和成本压力,显现我国的多年度发展的品牌认知和成本竞争劣势,抵消国际市场的“数量”优势,做好危机防范。
2、市场因素:
(1) 宏观经济波动带来的国际大公司的危机和成本压力,显现我国的多年度发展的品牌认知和成本竞争劣势,抵消国际市场的“数量”优势,做好危机防范。

3、国际市场需求萎缩,给公司经营带来一定的影响;
4、原材料价格波动是成本价格波动的重要因素,给公司经营带来一定的影响;
5、由于国内最终用户对产品质量的差异化需求,导致公司国内市场开拓难度高于国外市场。

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会对公司利润分配或资本公积金转增股本预案
除预计,公司 2008 年度实现净利润为 16,794,821.48 元,加年初的未分配利润 104,567,200.40 元,减去按照公司 2008 年实现的净利润提取 10%法定公积金 1,679,482.16 元和已分配的 2007 年股利 38,333,640.00 元,本年可以用于股东分配的未分配利润为: 81,348,899.72 元。公司以 2008 年末总股本 27,600 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计 828 万元;尚余 73,068,899.72 元,结转下年度。

公司前三年现金分红情况
单位:人民币元

年份	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于上市公司所有者的净利润	占所有者的净利润的比率
2007年	3,833,640.00	26,773,902.13	14.32%
2006年	13,800,000.00	31,560,004.77	43.73%
2005年	11,474,679.14	31,029,034.28	36.66%

公司未来现金分红和利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
6.10 募集资金使用情况
6.11 证券投资情况
6.12 衍生品投资情况
6.13 委托理财情况
6.14 承诺事项履行情况
6.15 其他重大事项的说明
6.16 利润分配或资本公积金转增股本预案
除预计,公司 2008 年度实现净利润为 16,794,821.48 元,加年初的未分配利润 104,567,200.40 元,减去按照公司 2008 年实现的净利润提取 10%法定公积金 1,679,482.16 元和已分配的 2007 年股利 38,333,640.00 元,本年可以用于股东分配的未分配利润为: 81,348,899.72 元。公司以 2008 年末总股本 27,600 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计 828 万元;尚余 73,068,899.72 元,结转下年度。

公司前三年现金分红情况
单位:人民币元

年份	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于上市公司所有者的净利润	占所有者的净利润的比率
2007年	3,833,640.00	26,773,902.13	14.32%
2006年	13,800,000.00	31,560,004.77	43.73%
2005年	11,474,679.14	31,029,034.28	36.66%

公司未来现金分红和利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
6.10 募集资金使用情况
6.11 证券投资情况
6.12 衍生品投资情况
6.13 委托理财情况
6.14 承诺事项履行情况
6.15 其他重大事项的说明
6.16 利润分配或资本公积金转增股本预案
除预计,公司 2008 年度实现净利润为 16,794,821.48 元,加年初的未分配利润 104,567,200.40 元,减去按照公司 2008 年实现的净利润提取 10%法定公积金 1,679,482.16 元和已分配的 2007 年股利 38,333,640.00 元,本年可以用于股东分配的未分配利润为: 81,348,899.72 元。公司以 2008 年末总股本 27,600 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计 828 万元;尚余 73,068,899.72 元,结转下年度。

公司前三年现金分红情况
单位:人民币元

年份	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于上市公司所有者的净利润	占所有者的净利润的比率
2007年	3,833,640.00	26,773,902.13	14.32%
2006年	13,800,000.00	31,560,004.77	43.73%
2005年	11,474,679.14	31,029,034.28	36.66%

公司未来现金分红和利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
6.10 募集资金使用情况
6.11 证券投资情况
6.12 衍生品投资情况
6.13 委托理财情况
6.14 承诺事项履行情况
6.15 其他重大事项的说明
6.16 利润分配或资本公积金转增股本预案
除预计,公司 2008 年度实现净利润为 16,794,821.48 元,加年初的未分配利润 104,567,200.40 元,减去按照公司 2008 年实现的净利润提取 10%法定公积金 1,679,482.16 元和已分配的 2007 年股利 38,333,640.00 元,本年可以用于股东分配的未分配利润为: 81,348,899.72 元。公司以 2008 年末总股本 27,600 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计 828 万元;尚余 73,068,899.72 元,结转下年度。

公司前三年现金分红情况
单位:人民币元

年份	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于上市公司所有者的净利润	占所有者的净利润的比率
2007年			